

研究タイトル:

**電解援用による新たな硬脆材料向け研磨システムの開発**



氏名: 池田 洋 / IKEDA Hiroshi E-mail: ikeda@akita-nct.ac.jp

職名: 教授 学位: 博士(工学)

所属学会・協会: 日本機械学会, 精密工学会

キーワード: 電界, CMP, スラリー, 硬脆材料, 研磨レート, 砥粒, SiC, ガラス, サファイア, 研磨装置

技術相談  
提供可能技術: 電界を援用した各種硬脆材料(ガラス, SiC, Si, サファイア等)の高効率CMP技術開発  
電界制御システムを組み込んだ研磨装置の開発  
研磨装置を含む各種装置のメカ・電装設計開発全般

研究内容:

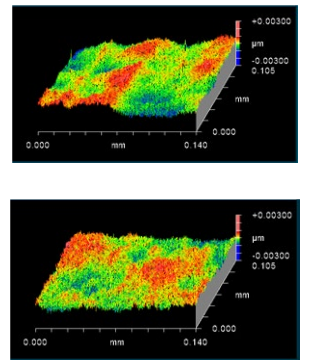
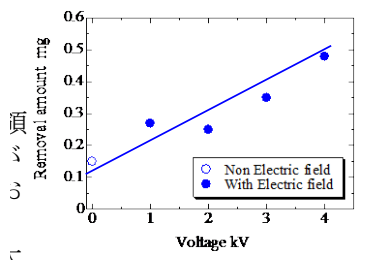
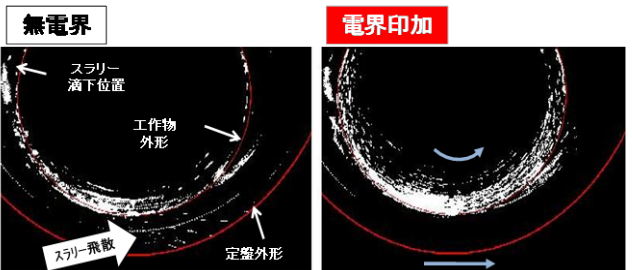
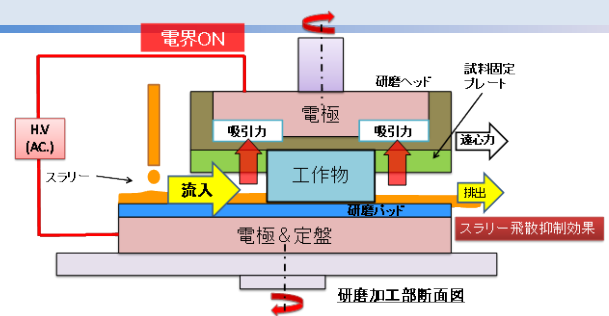


図4 研磨後の工作物表面状態

提供可能な設備・機器: (公開記事の有無を付記願います)

| 名称・型番(メーカー) |  |
|-------------|--|
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |